

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2024-047

北京晶品特装科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议
回购方案实施期限	2024年2月6日~2025年2月5日
预计回购金额	6,000万元~10,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	1,523,639股
累计已回购股数占总股本比例	2.0138%
累计已回购金额	66,532,789.27元
实际回购价格区间	32.13元/股~56.10元/股

一、回购股份的基本情况

（一）基本情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-002)。

(二) 回购股份资金总额调整

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》, 同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币 3,000 万元(含), 不超过人民币 5,000 万元(含)”调整为“不低于人民币 6,000 万元(含), 不超过人民币 10,000 万元(含)”。根据《公司章程》的相关规定, 本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过, 无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号: 2024-017)与《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号: 2024-018)。

(三) 回购股份价格上限调整

根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号: 2024-018)(以下简称“《回购报告书》”)约定: “如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项, 公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 对回购股份的价格上限进行相应调整。”由于公司在回购期限内实施了现金分红, 因此公司对回购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》, 本次回购股份价格上限由不超过人民币 90 元/股(含)调整为不超过人民币 89.80 元/股(含), 调整后的回购股份价格上限于 2024 年 6 月 13 日生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2024-026)。

除上述调整外, 公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——回购股份》等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年11月，公司未回购股份。

截至2024年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,523,639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66,532,789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2024年12月3日